

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-009

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他		
参与单位名称及人员姓名	中信证券 高级经理 王静元 中信证券 制造分析师 安家正 横店禹山 分析师 闫志远 深圳泽兴资产 投资经理 张涛 深圳泽兴资产 业务经理 朱昆文 深圳泽兴资产 王涛涛 深圳泽兴资产 王勇 深圳泽兴资产 张雷 深圳市固特佳制造技术有限公司 总经理 严利达 深圳君弘资产 投资经理 谢德桥 广州宸泽私募 合伙人 谢甘霖 浦发银行新安支行 行长 柯美霞 浦发银行新安支行 客户经理 彭纪林 金鹰基金 研究员 刘雅琪 中安汇富 研究员 张帆		
时间	2026年10月16日		
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎先生		

投资者关系活动主要内容介绍	7、请简单介绍一下公司情况与发展机遇 首先企业整体上归属于工控。企业技术与产品主要是运动控制核心部件与系统，广泛应用于数控机床、半导体/泛半导体设备为代表的高端机电设备中。运控技术与部件应用领域不局限于工业机电设备，但企业目前主要营收来自工业加工的机电装备。 作为机电整机装备上游的部件与系统供应节点，对于行业发展机遇，企业有一点粗浅的观察与思考： 欧美日韩等世界上的强大或曾经强大的工业强国或地区，它们的工业历程基本上经历过两个阶段：一般制造业阶段，然后是高端制造业或者先进制造业阶段。这两个不同的阶段实际上对生产工具（工业机电设备）有着不同需求；在进行汽车、飞机、芯片制造时，对机床、半导体装备等高端微纳装备的需求就很大，明显有别于纺织、家具等一般制造业。大陆自从改革开放、进入WTO已数十年，工业逐步向高端化转型。当下，汽车、飞行器制造业、造船、高铁，甚至是半导体芯片领域的制造业都在爆发。制造业高端化带动着整个机电装备高端化的发展趋势，企业认为类似半导体/泛半导体设备、高端数控机床、机器人、3C产品精密加工设备等机电装备领域所需的核心部件、系统是公司真正的发展机遇。 2、面向高端装备提供核心部件与系统，公司自身优势是什么？ 公司自成立之初，就定下了解决高端装备核心技术问题的愿景，并坚持至今。经过多年沉淀，企业在技术与产品、生态圈认可两个维度建立了竞争力。 首先基于正向、自主的研发，企业搭建了运动控制+伺服+感知与通信+软件的全栈可控技术体系，面向微米、亚微米、纳米级机电装备应用形成了控制器、驱动器、编码器、系统等相对完善的产品体系。 另外，在前面十多年LED产业快速发展时，公司抓住功率半导体芯片后道封装加工相关设备的机遇，在半导体/泛半导体这种微纳精度伺服装备领域实现了批量应用，如固晶机、键合机、划片机等，算是进入了泛半导体装备领域，之后持续沉淀技术与应用案例，才有更多机会逐步拓展到半导体前道、后道相关多种加工工艺设备，覆盖越来越多的应用场景。在高端机床领域也是类似情况。
----------------------	--

	3、公司在光通信相关业务的增长迅速，后期是否仍会有新增客户或较大业务增量？ 您这里提到的光通信应该是指今年市场上的光模块。 受AI基建拉动，公司的控制器、驱动器等产品在光通信或者说光模块相关加工装备中的应用今年确实有不错的增长。 这里就问题稍拓展下：光模块相关加工装备如耦合、固晶与共晶等设备，我们一直归口在泛半导体领域。目前市场热点的800G以上模块耦合加工，对准精度在数十个纳米。 光模块加工相关设备的电控，公司这里2025年底有较好的交付。进入2026年后，仍然保持了很好的增长，此细分领域的业务对公司上半年营收有较好的支撑。从目前市场初步反馈来看，明年的需求还是会保持较好的增长；但最终的呈现还是要通过逐个季度的仔细观察并验证。 4、公司认为高端装备的电控是个长期成长的贝塔，对光模块相关领域有这么大的预期吗？ 公司一直把光模块相关装备归口在半导体/泛半导体装备内。市场相对宽泛的定义中，半导体大致包括逻辑半导体、功率半导体、光电半导体、模拟半导体等。 公司认为以半导体/泛半导体装备为代表的高端微纳机电装备与相应的核心部件/系统可能会有一个不错的中长期发展空间。在这个框架下，光模块可能在现阶段是市场的一个爆点。 公司也在预期光模块相关加工设备之后，类似刻蚀/沉积/清洗等前道加工装备、精密量测装备、先进封装装备等细分领域的需求释放。这样多个细分领域持续释放才能真正走出一个中长期的贝塔。 请各位注意，以上仅是企业自身的观察与乐观期望，不能代表产业实际走向，也不能作为投资依据。需要各位仔细观察未来产业真实的走向，作出自己的判断，并评估投资风险。 5、无论在前道还是后道，公司在产业第一线的进展状况如何？以三年、五年为维度，能做到什么量级？ 发展中可能比较大的变数在于前道设备、量测与先进封装等几
--	---

	个领域。公司在前道设备尝试进入较早，甚至早于光模块耦合机。但光模块加工设备领域商业周期落地目前看来更为顺畅。而高端装备各领域应用落地都有这种进入周期长的特点。 从整体上来看，半导体/泛半导体设备国内市场规模冲上千亿，甚至两千亿。这里面电控的规模达到百亿是可以预期的，虽然目前公司产品线覆盖不够全，但即便只折算几成，其中的空间仍然非常充分。 6、半导体这块与客户的具体合作模式是怎样的？ 公司交易的方式还是产品销售。 7、公司在松山湖有一个产业基地，目前建设情况如何？建好后投产了吗？产能规划如何？ 松山湖产业园是IPO前已完成建设的，建筑面积约四万平方米。IPO募集资金中有部分用于产业化建设，目前在推进中。 公司产品生产中还保有一定的委外加工环节，26年相对之前交货确实出现了一定的压力。之前基本能保持1周发货，现在部分产品交期会需要2周多一些。但整体上横向比较业内，还是保持着较好的交货周期。 8、对下半年与明年，公司哪个市场领域预期最为乐观，半导体吗？ 目前公司觉得还是半导体/泛半导体装备领域可能增长较为乐观。公司在数控机床领域也发展良好，保持稳定成长。 另外，业界也有声音预期明年3C自动化领域的反弹。 请注意，这些预期都是公司基于行业情况的模糊感知，不能作为投资依据；需投资者逐个周期仔细验证分析并自行做出判断。
附件清单（如有）	无